

ECPELCS001-0

Stackup

Cliente: Rototype

Codice lavoro: 2000334103AK Autore: Stefano Pelizzari

Revisione: 2 **Data**: 27/02/2020

Numero layer	12
Spessore	1.7mm +/- 0.1mm
Dimensione stampato	250mm x 160mm
Foro minimo (tutti i fori passanti, no blind/burried vias)	0.2mm (diametro corona 0.35mm)
Dimensione minima pista	0.09mm
Isolamento minimo (esclusi piani diffusi)	0.077mm
Isolamento minimo piani diffusi layer esterni	0.25mm
Isolamento minimo piani diffusi layer interni	0.15mm

Tabella impedenze

Type	$Z_0[\Omega]$	Width [um]	Gap [um]	Layer
Single ended	50	100	N.A.	All routing layers
Differential	85	130	150	L4 e L9
Differential	85	140	150	L6 e L7
Differential	90	100	100	All routing inner layers
Differential	100	100	240	L4 e L9
Differential	100	100	185	L6 e L7

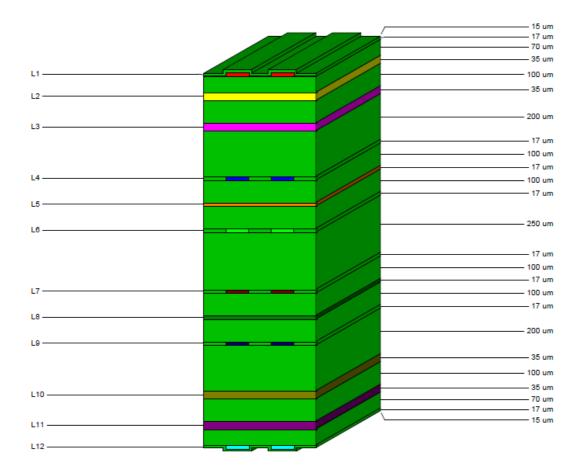
P.C.B. DESIGN di Tameni Simone & c. s.a.s.

Sede Legale: Via Ospitale 4, Nave (BS) | Tel. +39 0302055853 Uffici: Via S.lle Minola 23, Nave (BS) | Tel./Fax +39 0302530035

P.IVA/CF: IT03232210173 | Reg. imprese BS029-51594 | R.E.A. 344766







Total thickness = 1696 um

Indice revisioni

REV0 (05/12/2019)

• prima emissione

REV1 (18/12/2019)

• modificato diametro minimo vias da 0.4mm a 0.35mm

REV2 (27/02/2020):

- modificato spessore rame stackup (35um sui layer power)
- ridotte dimensioni minime pista e isolamenti

P.C.B. DESIGN di Tameni Simone & c. s.a.s.

Sede Legale: Via Ospitale 4, Nave (BS) | Tel. +39 0302055853 Uffici: Via S.lle Minola 23, Nave (BS) | Tel./Fax +39 0302530035

P.IVA/CF: IT03232210173 | Reg. imprese BS029-51594 | R.E.A. 344766



QAIC/IT/90342-A